

2022年8月10日

各位

会社名 日本電解株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 中島 英雅  
(コード番号: 5759 東証グロース)  
問合せ先 執行役員(財務担当) 増田 信昭  
E-Mail: [ir\\_team@nippon-denkai.co.jp](mailto:ir_team@nippon-denkai.co.jp)

## 2023年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向等を踏まえ、2022年5月13日に公表した2023年3月期通期の連結業績予想を下記のとおり修正いたしますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 2023年3月期 通期連結業績予想数値の修正 (2022年4月1日～2023年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (当初予想) (A)	百万円 20,935	百万円 435	百万円 219	百万円 25	円 銭 3 48
今回修正予想 (B)	18,000	△ 500	△ 800	△ 800	△110 34
増減額 (B-A)	△ 2,935	△ 935	△ 1,019	△ 825	—
増減率 (%)	△ 14.0	— *	— *	— *	— *
(ご参考) 前期実績 2022年3月期	20,558	1,004	976	848	117 22

\* 赤字と黒字、正の値と負の値との比較となるため、増減率の表示を省略しております。

#### 2. 修正の理由

最近時点において、一部主要顧客における販売シェア低下等の要因により販売が低迷する状況にあり、連結売上高は2022年5月13日に公表した業績予想(以下「当初予想」と表記)を下回る見込となりました。また、生産数量減少による操業度の低下

に加えて、電力単価高騰等のコストアップにより、営業利益以下の各段階利益についても当初予想を下回ると想定されるため、業績予想数値の修正に至りました。

## ■ 売上高の見込

連結売上高は、主として、一部主要顧客における販売シェア低下、中国スマートフォン需要の低迷、半導体供給不足の長期化により、当初予想より約 30 億円減少し、180 億円（当初予想 20,935 百万円）となる見込です。

一部主要顧客におけるシェアダウンにより車載電池用銅箔の受注数量が、また中国スマートフォン向け需要の減速が顕著となり回路基板用銅箔の受注数量が、各々当初予想を下回ると予想されます。また半導体供給不足による影響において、当初予想では、第 1 四半期に受注数量の減少（営業利益への影響△約 3 億円）を見込むとともに、第 2～3 四半期にかけて状況が徐々に改善し、需要が回復する（営業利益への影響+約 3 億円）ものと想定しておりました。しかし、その好転が当面見込めないと判断される状況より、その影響が 2022 年度内一杯残るものと前提条件を変更するとともに、車載電池用銅箔、回路基板用銅箔ともに売上高予想を見直しました。

## ■ 損益の見込（営業利益ベース）

営業利益は、当初予想の約 4 億円から約 9 億円減、△約 5 億円の赤字となります。これは、前項（売上高見込）でお示しした販売減少要因（当初予想以降の営業利益への追加的影響△約 8 億円）に加え、電力単価の高騰（同△ 2 億円）、米国子会社における生産障害（同△ 1 億円）、生産効率化・歩留改善・経費節減による収益挽回（同+約 1 億円）、銅価格の低下（同+ 1 億円）において見積りを修正するものです。

なお当初予想において見積もっておりました、製品価格の低下（営業利益への影響△約 2 億円）、米国設備改造に伴う数量減・費用発生（営業利益への影響△約 1 億円）については、当初想定より変更ありません。

### ● 電力単価の高騰

エネルギー・資源価格の高騰により、電力単価（燃料調整費）が上昇を続けております。営業利益への影響額は当初予想では△ 4 億円と見積もっておりましたが、昨今の情勢に鑑み△ 6 億円に見直します。

### ● 米国子会社における生産障害

米国子会社の製造設備にて故障が発生し、修理が完了する 8 月末ごろまで、生産活動が当初予想より低下する見込です。その営業利益への影響額は△ 1 億円となる見込です。

### ● 銅価格の低下

銅の市況価格低下による影響+1億円が発生する見込です。

### 3. 現状認識と収益挽回策

当社グループは現在、販売が低迷し、生産数量減少により操業度が低下しているところに、電力単価高騰等のコストアップ要因が重なり、収益が獲得しにくい状況にあると認識しております。

この状況を打開し、持続的な成長を取り戻すため、国内外の既存・新規顧客（バッテリーメーカー、基板メーカー）への拡販、次世代電池用銅箔や、5G以降の通信規格に対応する回路基板用銅箔等、高付加価値製品の開発・拡販に取り組むとともに、生産性改善のための投資（IoTの拡大等）等の施策を進め、販売数量の拡大、収益力の回復に取り組めます。

以 上

#### ※ 業績予想に関するご注意事項

本資料には、現在の予定、推定、見込又は予測に基づく将来に関する記述が含まれております。この将来に関する記述は、発表日現在において利用可能な情報をもとに、当社経営者が判断した内容に基づいております。将来に関する記述には様々なリスクや不確実性があり、諸々の要因の変化等により、この資料に記載の内容又はそこから推測される内容と大きく異なることがありますことをご了承ください。